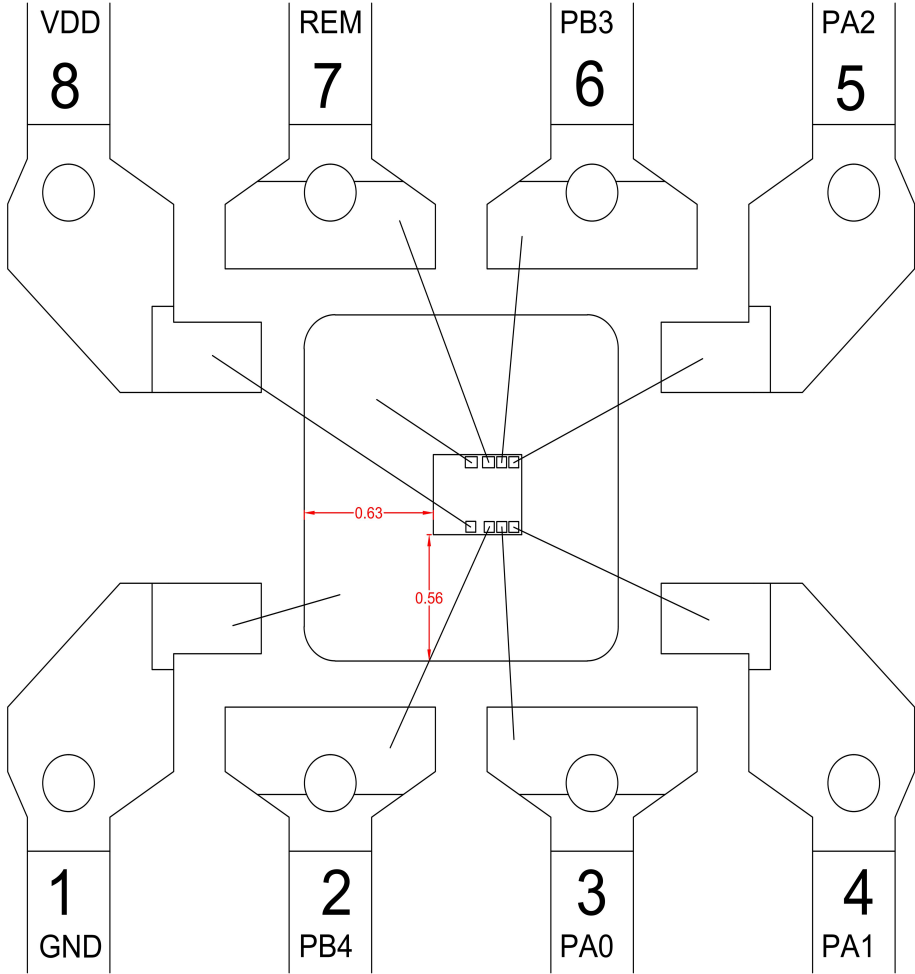




# 江苏恩微电子有限公司焊线图

焊线图编号		JSNV-0001-SZ037-SOP8L		版本信息					
				版本	修改内容		日期		
芯片名称		产品名称	封装形式	客户代码	A	初版发行		2024/9/30	
HS5156		HS9069	SOP8	SZ037					
								粘片注意事项	
								焊线注意事项 PAD下方是否有敏感器件： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 铝层厚度：0.8um	
								塑封注意事项	
								引线框进料方向	
封装形式	SOP8	芯片尺寸	429.4*353.4um	减薄厚度	300um	晶圆尺寸	8寸	划片槽宽	60um
框架型号	SOP8-12R-60*60			焊点尺寸	48.45*48.45, 48.45*57.95um			焊点间距	NA
吸嘴型号	RT-020			焊线类型	合金线			焊线条数	9
顶针型号	17-0.7-10-0.02			焊线线径	20um			起始管脚	NA
粘片胶类型	导电胶			铝层厚度	0.8um			铝层层数	3
粘片胶型号	首选：S210	劈刀型号	首选：SU2-25080-303F-RU34TP-Y	塑封料型号	首选：KHG 500				
	备选：				备选：				
备注：									
制图	陈菲菲	审核	陈爱强	批准	唐友胜	客户确认			
日期	2024/9/30	日期	2024/9/30	日期	2024/9/30	日期			